

การศึกษาโดยการทดลอง เรื่องลักษณะสมบัติทางไฟฟ้า

ของผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับแวนเพล็กซิลิกอน



นายสมบูรณ์ จงชัยกิจ

005219

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๖๗

Experimental study on electrical characteristics  
of metal - silicon contacts

Mr. Somboon Chongchaikit

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering  
Department of Electrical Engineering  
Graduate School  
Chulalongkorn University  
1980

หัวขอวิทยานิพนธ์

การศึกษาโดยการทดลองเรื่องลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของผ้าสัมผัสระหว่าง

โลหะกับแวนผลึกซีลิกอน

โดย

นายสมบูรณ์ จงชัยกิจ

ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุประดิษฐ์ บุนนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิน เวียร์วิชานะ)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)

..... กรรมการ

(อาจารย์ ดร.มนเชษฐ์ สรวัตศ์ฤทธิ์)

..... กรรมการ

(ดร.มนูญ อรุ่ำรัตน์)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**หัวข้อวิทยานิพนธ์** การศึกษาโดยการทดลองเรื่องลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับแวนพลีกชิลิกอน  
**ชื่อผู้ติดต่อ** นายสมบูรณ์ จงชัยกิจ  
**อาจารย์ที่ปรึกษา** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว  
**ภาควิชา** วิศวกรรมไฟฟ้า  
**ปีการศึกษา** 2522



บทสรุป

การหัวริชบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผิวสัมผัสแบบเรคติไฟบิง และผิวสัมผัสแบบโอล์มิก การศึกษาเรื่องผิวสัมผัสแบบเรคติไฟบิงอิงนั้นเลือกใช้การวิเคราะห์จากตัวอย่างที่มีโครงสร้างแบบซึ่งต้องให้โอล์มิกที่มี guard ring ส่วนผิวสัมผัสแบบโอล์มิกเลือกใช้การทดลองแบบ Transmission Line Model method โลหะที่ใช้ทำผิวสัมผัสได้แก่ อลูมิเนียม ทอง เงิน ตีบุก และนิเกล แวนพลีกชิลิกอนที่ใช้คือ แวนพลีกชิลิกอน ผิวสัมผัสถั่งมหาโพบวิชระ เที่ยวน้ำโลหะในสภาวะสูญญากาศประมาณ  $5 \times 10^{-6}$  ทอร์ ยกเว้นผิวสัมผัสระหว่างนิเกลกับแวนพลีกชิลิกอนซึ่งทำโดยวิธีขูบแวนพลีกในสารละลายเกลือของนิเกลที่อุณหภูมิ  $80^\circ$  เชลเซียต นอกจากนี้ยังได้ทดลองอุบความร้อนผิวสัมผัสระหว่างอลูมิเนียมกับแวนพลีกชิลิกอนที่อุณหภูมิ  $300^\circ - 600^\circ$  เชลเซียต นาน 20 นาที เพื่อถูกการเปลี่ยนแปลงของลักษณะสมบัติของผิวสัมผัสตังกล่าว

ผลการวิจัยแสดงว่าขั้นตอนการทำการฉบับโลหะจะเกิด interfacial layer ที่บริเวณผิวสัมผัสอยู่ทางหลังเสียงไม่ได้ แต่ interfacial layer จะทำให้ลักษณะสมบัติของผิวสัมผัสเลวลงกล่าวคือ 1. ลักษณะสมบัติของผิวสัมผัสแบบเรคติไฟบิงต่างไปจากอุบมคติทั่งผลการทดลองที่พบว่า กระแสในชุดย้อนแปรตามแรงดันไปขึ้นและกระแสไปยังสถานมีค่าต่ำลง 2. ผิวสัมผัสแบบโอล์มิกมีค่าความต้านทานสูง

การอุบความร้อนทำให้อิทธิพลของ interfacial layer ลดลง อลูมิเนียมเป็นโลหะที่เหมาะสมที่สุดในการทำผิวสัมผัสกับแวนพลีกชิลิกอน เมื่อจากเมื่ออบความร้อนอลูมิเนียมแรร์เอ็มเข้าไปในแวนพลีกชิลิกอนได้น้อยและอุณหภูมิที่ใช้ในการอบความร้อนไม่สูงนัก เพราะ eutectic temperature

มีค่าตัวพอมควร นอกจากนั้นอุณหภูมิเนี่ยมยังหาได้ยากและราคาสูง เงื่อนไขในการอบความร้อน  
ผิวส้มผู้สร้างหัวงอุณหภูมิเนี่ยมกับแวนแฟลิกซิลิกอนที่เหมาะสม คือ อบความร้อนที่อุณหภูมิ  $550^{\circ}-600^{\circ}$   
เซลเซียส นาน 20 นาที

ส่วนผิวส้มผู้สร้างหัวงนี้เกิดกับแวนแฟลิกซิลิกอนที่ทำขึ้นโดยวิธีขึบโลหะนั้น ปรากฏว่าแรงยืด  
เคารของขั้นโลหะกับแวนแฟลิกซิลิกอนไม่แน่นพอ จึงยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้ จนกว่าจะมีการ  
ปรับปรุงให้คุณสมบัติทางเคมานิคอลดังกล่าวดีขึ้น

## ABSTRACT

Two types of metal - silicon contacts, i.e. rectifying and ohmic contacts, were investigated. Rectifying contacts were prepared by using Schottky diode with diffused guard ring structure. Transmission Line Model method with three - point contact configuration was applied to ohmic contacts. Various kinds of metal, e.g. aluminium, gold, silver, tin and nickel were used. Most of the contacts were fabricated by evaporation of metal onto silicon wafers in vacuum at about  $5 \times 10^{-6}$  Torr., except nickel - silicon which were prepared by electroless plating method. Study on the heat treatment effect on aluminium - silicon contacts were carried on at temperature  $300^{\circ}$  -  $600^{\circ}\text{C}$  for 20 minutes.

The experimental results imply that there occurred an interfacial layer during contact formation. The interfacial layer degraded the following characteristics :- 1. The saturation current varying with reverse bias and smaller forward current of rectifying contacts were observed.

2. Ohmic contacts showed high contact resistances.

The effect of interfacial layer is decreased by sintering. The most appropriate metal for metal - silicon contacts is aluminium because

of its low diffusivity and low eutectic temperature. Aluminium is plentiful and low - cost, as well. The best sintering condition for aluminium - silicon contact is 550°- 600°C for 20 minutes.

The adhesive force of nickel to silicon wafers, prepared by electroless plating, is weak. Further development is required for future utilization.

กิติกรรมประกาศ

การวิจัยและวิทยานิพนธ์สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือแนะนำจาก ผศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว แห่งภาควิชาศึกษาธรรมะ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์ ในขณะดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆอย่างดีเยี่ยม ยิ่งทั้ง ผศ. ดร.สุทธิน เวทย์รักนะ และ ดร.มนูญ อรำมรตน์ ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านวิธีการใช้เครื่องมือในการวิจัยและตอบปัญหาทุกถี่บ้างล้วน อ.ดร.มนตรี สวัสดิ์ศฤทธิ์ และ Mr. Pierre Bernoux ผู้ช่วยแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสให้ผู้วิจัยอย่างละเอียด นอกจากนี้อาจารย์ทั้งสี่ท่านยังได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องบางประการและให้กำลังใจผู้ทำการวิจัยมาตลอด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ. ที่นี้ด้วย

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ทุนนำและเจ้าหน้าที่ธุรการ ภาคไฟฟ้าที่มีส่วนช่วยเหลือในการทดลองและงานธุรการต่างๆด้วยดี



## สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย .....	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	๘
กิติกรรมประกาศ .....	๙
รายการรูปประกอบ .....	๑๒
บทที่	
1. บทนำ .....	๑
2. ผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับสารกึ่งตัวนำ .....	๔
2.1 แบบจำลองในการพิจารณาผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับสารกึ่งตัวนำ .....	๔
2.2 ปรากฏการณ์ Image - Force .....	๑๓
3. การเคลื่อนที่ของพาหะผ่านผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับสารกึ่งตัวนำ .....	๑๕
3.1 กระบวนการต่างๆที่กำหนดค่ากระแส เมื่อผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับสารกึ่งตัวนำไปอัศatham (Forward bias) .....	๑๕
3.2 ลักษณะสมบัติของผิวสัมผัสฯ ทางด้านไปอัศัย้อน (Reverse bias) ...	๒๕
3.3 ผลของ Interfacial layer .....	๒๗
3.4 ผลของอุณหภูมิ .....	๒๘
4. การทำผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับสารกึ่งตัวนำในแบบปฏิบัติ .....	๒๙
4.1 วิธีการทำผิวสัมผัสฯ .....	๒๙
4.2 การทำผิวสัมผัสฯ แบบโอล์ฟ์มิก .....	๓๑
4.3 ผลของการอบความร้อน .....	๓๔
5. วิธีการวิเคราะห์ผิวสัมผัสแบบต่างๆ .....	๓๖
5.1 การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของผิวสัมผัสแบบเรคติฟายอิง .....	๓๖
5.2 การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของผิวสัมผัสแบบโอล์ฟ์มิก .....	๓๙
6. การทดลอง .....	๔๘



	หน้า
6.1 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างผิวสัมผัสแบบเรคติฟายอิง .....	48
6.2 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างผิวสัมผัสแบบโอล์มมิก .....	55
6.3 เงื่อนไขในการอบความร้อน .....	59
7. ผลการทดลอง .....	62
7.1 ผิวสัมผัสระหว่างแวนพลีกซิลิกอนกับอลูมิเนียม .....	62
7.2 ผิวสัมผัสระหว่างแวนพลีกซิลิกอนกับทอง .....	65
7.3 ผิวสัมผัสระหว่างแวนพลีกซิลิกอนกับเงิน .....	68
7.4 ผิวสัมผัสระหว่างแวนพลีกซิลิกอนกับดีบุก .....	71
7.5 ผิวสัมผัสระหว่างแวนพลีกซิลิกอนกับนิเกล .....	74
7.6 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะสมบัติของผิวสัมผัสฯ หลังจากอบความร้อน ..	76
8. สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ .....	80
เอกสารอ้างอิง .....	82
ภาคผนวก .....	87
ประวัติ .....	92

## รายการรูปประกอบ

รูปที่	หน้า
2.1 แบบพลังงานของวัตถุเมื่ออยู่แยกกัน .....	5
2.2 Dangling bond บริเวณผิวของสารกึ่งตัวนำ .....	5
2.3 แบบพลังงานของผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับสารกึ่งตัวนำชนิด P .....	7
2.4 แบบพลังงานของผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับสารกึ่งตัวนำชนิด N .....	7
2.5 แบบพลังงานของผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับสารกึ่งตัวนำชนิด N ที่มี Interfacial layer กั้นกลาง .....	8
2.6 แบบพลังงานของผิวสัมผัสฯ การมีระดับพลังงานของสารกึ่งตัวนำรับ .....	10
3.1 ขบวนการที่ประกอบเป็นกระแสแข็งผิวสัมผัสฯ ถูกใบอัลตรา .....	15
3.2 การเคลื่อนทะลุผ่าน Barrier ของอิเล็กตรอนขณะผิวสัมผัสถูกใบอัลตรา ..	21
3.3 การเคลื่อนทะลุผ่าน Barrier ของอิเล็กตรอนขณะผิวสัมผัสถูกใบอัลตรา ..	26
3.4 สักษณะสมบติของช่องโถกดที่มีความหนาอักไชค์ต่างกัน .....	27
4.1 รูปร่างซึ่งช่วยในการให้คำจำกัดความค่า Sheet resistance .....	31
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง $\rho_c$ กับ $N_d$ ของสารกึ่งตัวนำชนิด N .....	34
5.1 ผลการคำนวณหาค่า $F(V)$ .....	37
5.2 โครงสร้างของทรานซิสเตอร์แบบ n-p-n ซึ่งประกอบด้วยผิวสัมผัสแนวตั้ง และผิวสัมผัสแนวนอน .....	40
5.3 โครงสร้างของตัวอย่างในการทดสอบแบบ Twin Contact method .....	40
5.4 โครงสร้างของตัวอย่างในการทดสอบแบบ Differential method .....	41
5.5 โครงสร้างของตัวอย่างและวิธีหาค่า $V_0$ ในการทดสอบแบบ Extrapolation method .....	43
5.6 โครงสร้างของตัวอย่างและกราฟในการทดสอบแบบ Interface probing method .....	44
5.7 โครงสร้างของตัวอย่างในการทดสอบแบบ Transmission line model method .....	45

หน้า	
6.1 โครงสร้างของตัวอย่างในการวิจัยผิวสัมผัสแบบเรคติฟายอิง .....	50
6.2 ตัวอย่างในการวิจัยผิวสัมผัสแบบเรคติฟายอิง .....	51
6.3 Mask เบอร์ 1 และรายละเอียดของสัดส่วน .....	52
6.4 Mask เบอร์ 2 และรายละเอียดของสัดส่วน .....	52
6.5 Mask เบอร์ 3 และรายละเอียดของสัดส่วน .....	53
6.6 Mask เบอร์ 4 และรายละเอียดของสัดส่วน .....	53
6.7 โครงสร้างของตัวอย่างในการวิจัยผิวสัมผัสแบบโอลูมิก .....	56
6.8 ตัวอย่างในการวิจัยผิวสัมผัสแบบโอลูมิก .....	57
6.9 Mask เบอร์ 5 และรายละเอียดของสัดส่วน .....	58
6.10 Mask เบอร์ 6 และรายละเอียดของสัดส่วน .....	58
6.11 โครงสร้างและตัวอย่างในการวิจัยเงื่อนไขในการอบความร้อน .....	61
7.1 - 7.32 ความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันของตัวอย่างในการวิจัยแบบ โอลูมิกและแบบเรคติฟายอิง .....	62-73
7.33 - 7.36 ความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันของตัวอย่างในการวิจัยเงื่อนไข ในการอบความร้อน .....	76
7.37 การเปลี่ยนแปลงของผิวสัมผัสระหว่างอุณหภูมิ เนียมกับแวนผลิกซิลิกอน เมื่อทำการ อบความร้อน .....	77